

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-072

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于以定期存单等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、业务概述

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年银行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 169,000.00 万元人民币综合授信，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年银行综合授信的公告（更正后）》（公告编号：2024-013）。

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司拟以公司名下的新开以及未到期的单位定期存单、企业大额存单、结构性存款以及银行承兑汇票等金融资产质押，向南京银行股份有限公司苏州分行申请开具不超过人民币 20,000.00 万元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。额度内可循环使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

二、审议和表决情况

2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议表决通过了《关于以定期存单等资产质押申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

向银行质押定期存单等金融资产并开具等额银行承兑汇票符合公司实际业务情况及经营发展需要，能有效提高资金使用效率，降低资金成本，从而提升公司盈利能力，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

四、备查文件

《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日